



京セラ株式会社からの半導体関連材料を 中心としたケミカル事業の譲受について

2026年1月22日
住友ベークライト株式会社

目次



1. 事業譲受の概要
2. 当社の狙い

1.事業譲受の概要

当社が戦略領域とする**ICT領域**のさらなる成長を目指し、

京セラ株式会社より**半導体封止材、ボンディングペースト**などの事業を譲受する

京セラの**プロセッサー、メモリー、パワーデバイス**向け高熱伝導技術



当社の**顧客ニーズ**に幅広く応えてきた高い技術力と
グローバルカスタマーサポート体制



AIデータセンター半導体向けなどに
圧倒的な高熱伝導特性を持つ材料ラインナップを拡充する

→2030年度 全社事業利益550億円をより確実なものにする

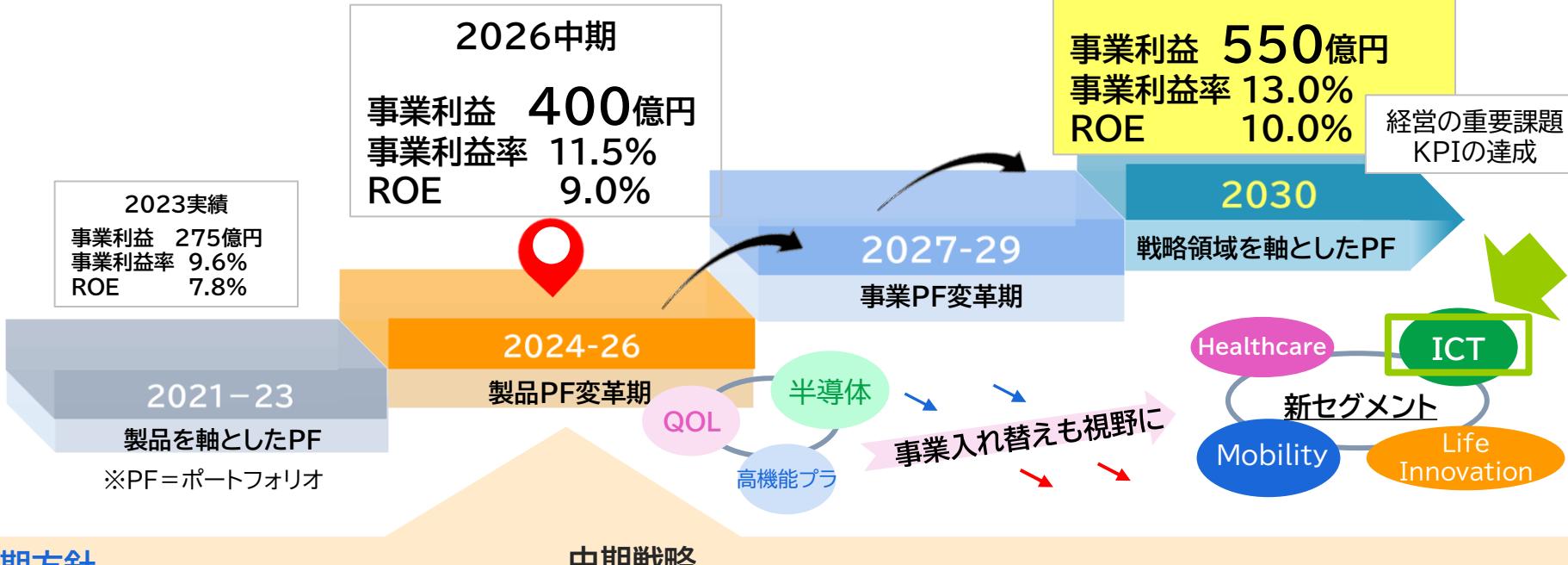
1.事業譲受の概要

譲受する事業	半導体用エポキシ封止材、半導体用ペースト、工業用樹脂等の製造および販売
承継する事業所	川崎(神奈川)、真岡(栃木)、郡山(福島)、無錫(中国)
スキーム	同事業を吸収分割により承継する会社の全株式を取得し、子会社化
クロージング 予定日 ^(注1)	2026年10月
株式譲渡価額 ^(注2)	300億円

(注1)競争法に関する手続等の進捗状況により、変更となる可能性がございます。

(注2)最終的な取得価額は、株式譲渡契約に基づく価格調整を実施した金額となる予定です。

2030年ありたい姿の実現に向けて



中期方針

“ニッチ＆トップシェア”を目指し、
価値創造につながる
ポートフォリオ改革に挑戦する

中期方針・中期戦略

中期方針

“ニッチ＆トップシェア”を目指し、 価値創造につながるポートフォリオ改革に挑戦する

中期戦略①

製品構成を最適化し、 既存事業の収益力を強化

- 利益基準への転換
- 製品ポートフォリオ改革に向けて
高付加価値製品へシフト
- SB-ROIC(社内指標)を活用して
資本効率性の向上を図る
- 重点領域(半導体/モビリティ/
ヘルスケア)にリソースを集中

中期戦略②

SDGsに則した環境的・ 社会的価値を有する新商品/ 新ソリューションを創出

- SDGs貢献製品の創出
- ニッチ＆トップシェアを目指し、
カーボンニュートラルを意識した
新商品/新ソリューション開発
- 挑戦を全社で支援、提案型テーマの
実施をサポート
- 社外との協業強化・仕組みづくり
- 中長期視点で探索領域を設定

中期戦略③

個人の自律性と組織の 一体感を高め、全社力を 最大化

- 人間力向上、従業員エンゲージメント
向上を意識した各種取組みの企画・
実行
- 自律性の強化、組織力の向上を
目指した教育プログラムの実施
- CS/One Sumibe活動の推進
(組織を超えた自主的な連携)

投資方針

「資本コスト」を踏まえて経営資源を配分(2024-26年度)

キャッシュ・アロケーション

設備投資 **500億円**

成長投資 **200億円**

戦略的投資 **500億円**

株主還元 **300億円**

用途別資金使途見込み

既存事業の収益力強化(中期戦略①)・顧客への安定供給に資する設備投資をタイムリーに実行

新製品/新ソリューション創出(中期戦略②)に向けた研究開発、DX、GX対応を推進

有望案件発掘にむけた知の探索、オープンイノベーション推進、および
事業ポートフォリオ改革に資する戦略的M&Aを実行

“安定的かつ継続的に利益を還元する”
配当性向: 40%程度を目指す (従来目安30%以上から変更)

目次



1. 事業譲受の概要
2. 当社の狙い

ビジネス動向 2030年メガトレンド

・DX:デジタルトランスフォーメーション ・GX:グリーントランスフォーメーション

DX

GX

①高度情報処理装置類



AI(クラウド、エッジ)高速通信
ブロックチェーン データセンター,サーバー

②カーエレクトロニクス類



インフォテインメント 自動運転
インバーター パワーデバイス

③モビリティ装置類



モーター ECU,TCU
蓄電池 紙電

④モバイル機器類



AR/VR
スマホ、タブレット ウェアラブル
PC

⑤ロボティクス



協働
遠隔医療 ドローン
手術支援

⑥再生エネルギー

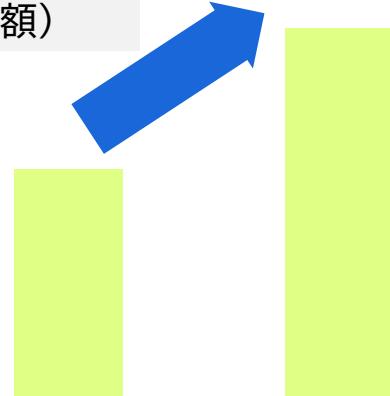


太陽光発電
水素 風力発電
二酸化炭素

AI,パワーデバイス,モビリティの3領域を注目・強化

半導体市場の構成と成長見通し

CAGR 10%
(金額)



半導体市場の年平均成長率 約10%
特に伸長が期待されるのは、AIデータセンター

プロセッサー、メモリー、パワーデバイス
の高機能化と市場成長が進む



FY2024

FY2029

※Prismark社資料をもとに当社編集

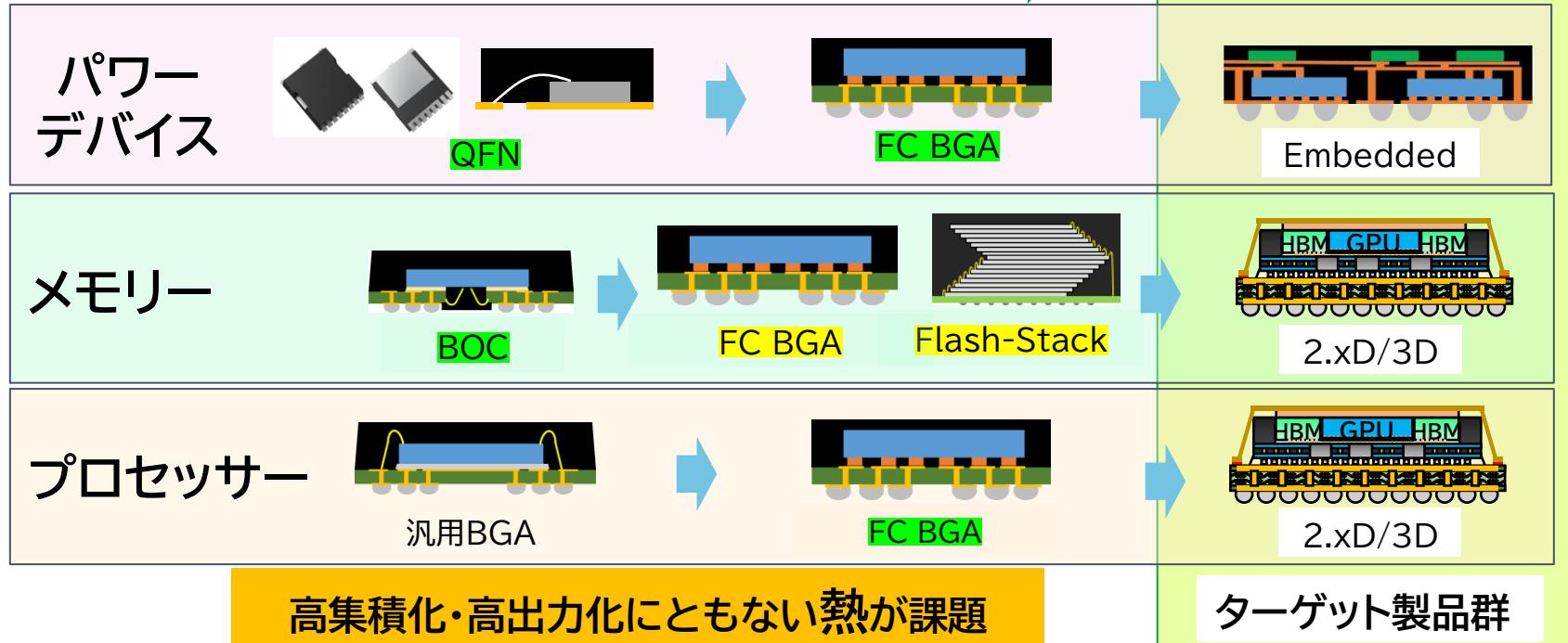
AIデータセンター用途では半導体の高集積化に伴う熱密度の高まりや、
消費電流の増大により、熱への対応がますます大きな課題

AIサーバーで使用される半導体

当社の強み

京セラの強み

半導体パッケージの進化



パワーデバイス、メモリー、プロセッサーで両社の技術を融合し、シナジーを創出

事業譲受によるシナジーの創出

住友ベークライトの強み

顧客ニーズに幅広く応えてきた高い技術力と
グローバルのカスタマーサポート体制



半導体封止用
エポキシ樹脂成形材料



半導体用
ボンディングペースト



半導体用
感光性材料



半導体基板材料
LαZ®



主要な半導体市場で
地産地消体制を確立



京セラの強み

独自の
高熱伝導技術



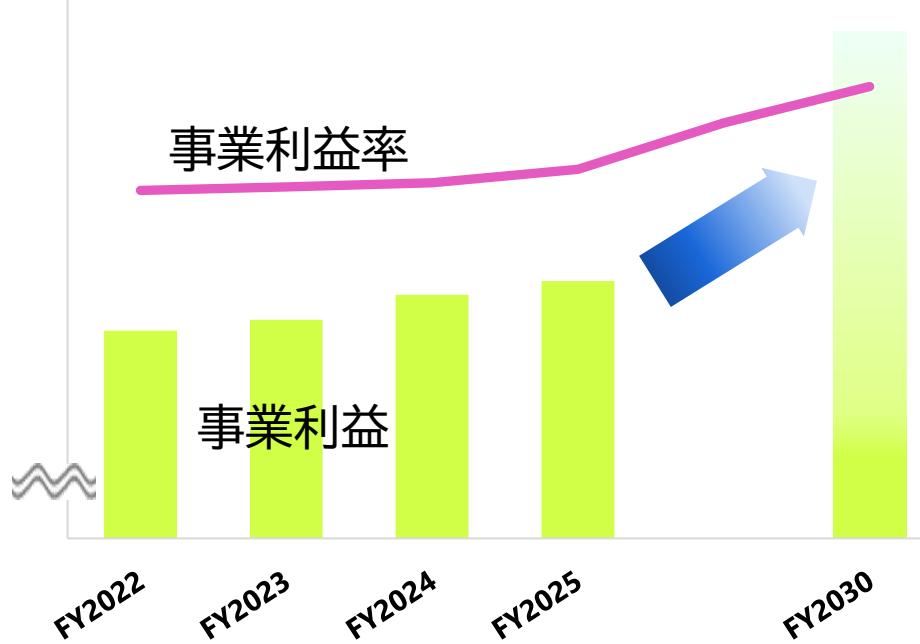
半導体封止用
エポキシ樹脂成形材料



半導体用
ボンディングペースト

AIデータセンター半導体向けなどで圧倒的なプレゼンス向上

半導体関連材料事業セグメントの成長を加速



プロセッサー
メモリー
パワーデバイス
など熱が課題となるデバイスへ
**圧倒的な高熱伝導特性を持つ
高付加価値品を顧客へ提供**

市場の成長+シナジーの創出により、
半導体関連材料事業セグメントの成長を加速



SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

<https://www.sumibe.co.jp/>

■ 免責事項について

当社は、本資料の情報がお客様にとって有用なものとなるよう努めていますが、特定の用途における正確性や妥当性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、関連する用途との適合性や安全性を別途ご検証ください。また、本資料に含まれるいかなる事項も、知的財産権等に関する助言や許可を与えるものではありません。

■ 著作権について

本資料の著作権は、特に断りのない限り、当社またはその関連会社に帰属します。当社の許可なく、本資料を無断で複製または転用等をすることを禁止しております。

■ 会社名の表記方法について

本資料における会社名の表記にあたっては、「株式会社」等の表記を省略している場合があります。